

半導体実装概論

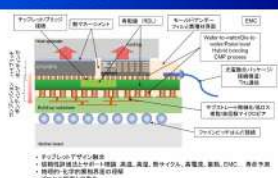
講師 大阪大学 フレキシブル3D実装協働研究所
所長/特任教授/名誉教授 菅沼 克昭氏



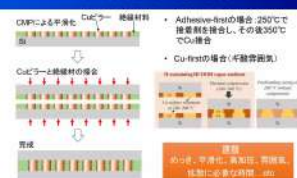
半導体パッケージの進化、その中での微細接合技術とサブストレート技術、樹脂封止と絶縁技術の材料とプロセス、更にパッケージの信頼性として評価技術や熱特性のシミュレーション技術を解説し、最後に今後のパッケージングについてお話しします。

※画像はイメージです。※講座内容は一部変更になる場合がございます。

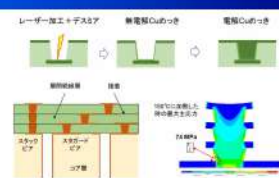
先端半導体パッケージの進化



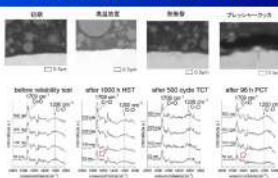
微細接合技術



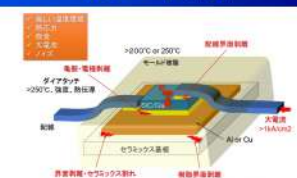
サブストレート



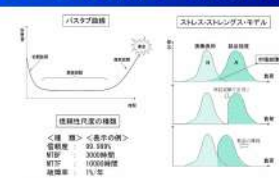
樹脂封止・絶縁技術



パワー半導体



パッケージ信頼性 最後にまとめ



2025年8月29日(金) 10:00~17:00

お申し込み期間は 2025年5月29日(木) 9:00から 2025年8月26日(火) 17:00までとなります。

受講料 33,000円(税込)

対面受講・オンライン受講 同時開催
定員 | 対面40名 / オンライン90名



●対面受講会場

福岡システムLSI総合開発センター
2F 講義室
住所 福岡市早良区百道浜3-8-33

●オンライン受講会場 Zoom

(接続先リンクはお支払い完了後にご案内)



●お申込み方法

ふくおかISTe-learningのホームページより、「講座・セミナー等 申込」をクリックし、「半導体実装概論」の「対面受講申込」または「オンライン(OL)受講申込」を選択ください。

ふくおかISTe-learning

検索

本講座に関するお問合せは下記までお願いいたします。

e-mail : reskilling_contact@ist.or.jp TEL 092-822-1550

公益財団法人 福岡県産業・科学技術振興財団
福岡半導体リスキリングセンター 事務局

- 対面受講、オンライン受講は同価格になります。 ■ お申込みに、ふくおかISTe-learningへの会員登録が必要です。
- お支払い後、当日の参加有無にかかわらず返金はいたしません。 ■ 福岡県内中小企業の方には、受講料補助制度があります。
- 講座当日、全受講者にpdfテキスト(コピー・印刷不可、コメント追加可)配布、対面受講者には紙テキストも配布します。なおテキストの無断転載・複製等は禁止しています。
- オンライン受講は2画面(画面拡張モード:Zoom画面とpdfテキスト画面)を推奨します。 ■ 特段の事情が発生した場合、やむを得ず中止、又は延期する場合がございます。



福岡県内 中小企業の方は **受講料全額補助**

※消費税及び地方消費税を除く



詳細はこちら

補助には条件がございます。
お申込みの前に福岡半導体リスキリングセンターのホームページから、申請要領・交付要綱をご確認ください。



公益財団法人 福岡県産業・科学技術振興財団

福岡半導体リスキリングセンター